

佛山市联动科技股份有限公司

代码：301369 ISIN：

成立日期	1998/12/07	邮箱	ir@powertechsemi.com
上市日期	2022/09/22	电话	(+86)0757-83281982
官方网站	http://cn.powertechsemi.com/	传真	(+86)0757-81802530
注册地址	广东省佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号	办公地址	广东省佛山市南海区国家高新区新光源产业基地光明大道16号

业务概况（更新日期：2024/06/18）

公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。公司坚持创新驱动发展的战略，公司自主研发的功率半导体测试系统实现了进口替代。

公司是国内领先的功率半导体测试系统供应商之一，也是少数进入国际封测市场供应链体系的中国半导体设备企业之一。

公司将行业前沿的技术与创新思维相结合，持续追求半导体专用设备相关产品及技术的革新。公司在功率半导体测试系统、集成电路测试系统、激光打标设备及机电一体化设备等产品技术领域均有成熟的研发经验。此外，公司承担国家科技部创新基金项目，通过了国家高新技术企业及国家鼓励的软件企业认定，被广东省科学技术厅认定为广东省半导体集成电路封装测试设备工程技术研究中心。

公司自成立以来，一直坚持自主创新，旗下产品填补国内技术空白。公司的QT-4000系列功率器件综合测试平台，能满足高压源、超大电流源等级的功率器件及功率模块的测试要求，测试功能涵盖直流及交流测试并能够进行多工位测试的数据合并，包括但不限于直流参数测试（DC）、热阻（TR）、雪崩（EAS）、RG/CG（LCR）、开关时间（SW）、二极管反向恢复时间（TRR）、栅极电荷测试（Qg）以及浪涌测试等，是目前国内功率器件和功率模块测试能力和功能模块覆盖面最广的供应商之一。

公司新推出的QT-8400系列测试平台，主要用于IGBT及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，能够满足电动汽车、新能源等工业领域日益增长的测试需求和新的应用场景。目前，该测试平台市场推广效果良好，已实现量产。

公司近年来推出的QT-8000数模混合信号集成电路系列产品，凭借差异化的竞争优势，在多工位并行测试、射频模块测试、高精度测试等方面，已逐步得到客户的认可。

在小信号分立器件测试领域，公司旗下QT-6000系列产品是国内较早实现自主研发、生产的高速分立器件测试系统之一，能够满足小信号器件多工位并行测试要求，具有较高的测试效率。QT-6000系列产品的测试UPH值可达60k，达到国际先进水平。

公司亮点（更新日期：2024/06/18）

1、技术研发优势

公司在半导体自动化测试领域技术储备深厚，产品具备较高的技术壁垒。公司是国内功率半导体及第三代半导体测试能力和测试功能模块覆盖面最广的设备供应商之一，产品在关键技术指标上能够达到同类产品的国内领先、国际先进水平，具有较强的产品竞争力；公司集成电路测试系统具备对于模拟和数字信号的测试能力，测试产品的主要性能和指标与同类进口设备相当。

半导体专用设备领域属于具有较高技术门槛、需要大量专业技术人才及研发资源投入的高精尖领域。因此，公司深谙技术研发投入程度对于技术导向型企业发展的重要影响，自成立以来便将技术研发投入纳入战略经营计划之中，不断根据市场发展状况与业务运营情况，始终专注于半导体封装测试领域所需设备及技术的研发及产业化应用。

2、市场先发优势

公司成立于1998年，在半导体自动化测试系统和激光打标领域深耕多年，具备较强的市场先发优势和丰富的产品应用经验。凭借着稳定的产品质量和良好的市场口碑，公司自主研发的半导体分立器件测试系统实现了进口替代，在国内半导体分立器件测试系统市场占据领先地位，拥有业内知名厂商的客户资源，客户黏性较强，具有较高的客户壁垒。

3、丰富的产品线优势

公司具备丰富的产品线，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备和其他机电一体化设备，能够满足其不同产品在封测产线上不同工艺环节的细分需求，具备设备整体交付和封测产线配套综合服务能力。公司的产品矩阵朝着封测产线测试系统全覆盖、测试能力高端化、激光打标全自动化的方向发展，能够进一步为封装测试企业提供更多元化的产品组合，从而提升公司在产品配套组合方案方面的市场竞争力。

4、本土化服务优势

公司主要客户覆盖国内外知名的半导体厂商、封测龙头企业，公司具备完善的销售网络，能够贴近客户，及时满足客户需求，相较国际封测设备供应商具有更强的本土化销售及服务优势。公司已在佛山、上海、成都、无锡、马来西亚等代表性市场区域建立起推广及服务网点，能够覆盖华南、华东、西北、东南亚等主要市场，快速响应客户需求、持续拓展当地业务。公司内部已建立起完善的服务响应体系，能够根据产品方案 and 实际问题的紧急与复杂程度，协同市场营销中心、研发中心、生产中心共同提供解决方案。

风险提示（更新日期：2024/06/18）

1.传统半导体分立器件测试领域市场容量相对较小且产品结构较为集中的风险

公司现有半导体测试系统产品线主要集中在半导体分立器件测试和模拟及数模混合信号集成电路测试，报告期内半导体分立器件测试系统收入占比较高。传统半导体分立器件测试领域市场容量相对较小，若未来传统分立器件测试领域市场容量增长不及预期或出现停滞，又或公司未及时开拓更多产品线，将对公司整体经营业绩产生不利影响。

应对措施：近年来，大功率器件/模块及第三代半导体在新能源及电动车等工业新兴应用保持高速增长，因此，该领域的测试需求还将保持良好的增长态势。公司在半导体分立器件测试领域深耕20余年，对中大功率器件测试和应用具有深厚技术储备和丰富的产品应用经验，对现有产品进行持续的升级迭代，不断提升公司在大功率器件/模块和第三代半导体器件/

交易信息

所属行业:	制造业
细分行业:	专用设备制造业
所属市场:	深交所创业板

董事及高管

董事长:	张赤梅
总经理:	郑俊岭
财务总监:	-
董事会秘书:	邱少媚
董事会成员:	张赤梅, 郑俊岭, 李凯, 张波, 杨格

前五大股东（截止日期：2024/03/31）

股东名称	持股数量(百万股)	持股比例(%)
张赤梅	22.95	32.90
郑俊岭	22.05	31.61
广东省粤科母基金投资管理有限公司-江门市粤科红墙创业投资合伙企业(有限合伙)	1.61	2.31
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.92	1.31
上海旷虹智能科技合伙企业(有限合伙)	0.85	1.21

营业收入（单位：百万元）

	第一季度	半年度	前三季度	年度
2024	58	-	-	-
2023	43	114	168	237
2022	-	194	271	350
2021	-	132	-	344
2020	29	-	-	202
2019	-	-	-	148
2018	-	-	-	156
2017	-	-	-	150

模块测试领域的竞争优势。

2.集成电路测试系统市场开拓和技术研发不及预期的风险

与国内外竞争对手相比，公司进入集成电路测试领域较晚，加之集成电路测试系统在客户端验证周期较长，根据被测器件的复杂程度，可能会涉及到上游芯片设计到下游芯片量产测试的整个验证过程，需要6–24个月不等，公司在集成电路测试领域的市场开拓进度相对较慢。未来若公司无法有效开拓集成电路测试系统市场，或客户认证进程未达预期，将对公司经营业绩的增长产生不利影响。目前，公司现有集成电路测试系统主要集中在模拟及数模混合信号集成电路测试，并已在进行 SoC 类集成电路测试系统的技术研发，若公司在未来无法克服相关技术困难，或相关技术无法形成测试系统投入量产使用，从而对公司未来的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将进一步加强集成电路测试系统市场推广和客户认证相关工作,并将通过加大研发投入，加大市场应用开发，保持设备的技术的先进性和应用便利性，降低新产品量产的风险。

3.宏观经济变化和行业波动的风险

公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售，位于半导体产业的上游。半导体产业处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础，与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。近年来，随着5G 通讯、物联网、汽车电子等新兴领域逐渐兴起及人工智能、大数据、云计算等技术逐渐成熟，全球半导体市场规模总体保持增长。未来，如果宏观经济形势发生重大变化、半导体行业景气度下滑，半导体企业的资本性支出延缓或减少，亦或由于国内半导体行业部分领域出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在行业景气度较低时超过市场需求出现过剩，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

消费类电子产品是半导体分立器件及集成电路最主要的应用领域。如果传统消费电子整体需求下降，可能造成对分立器件、集成电路的需求下降，进而影响公司产品的需求。公司存在受传统消费电子行业波动影响的风险。

应对措施：公司将围绕既定战略目标及经营计划开展各项工作，加大市场推广力度，尽可能减少宏观经济变化和行业波动带来的影响。同时，公司将持续加强对宏观经济形势的关注与研究，适应客户需求，及时调整业务、收款策略等措施，防范业务开展的风险。

4.原材料境外采购占比较高的风险

公司境外采购的原材料主要为继电器、集成电路芯片等电子元器件，境外采购的原材料金额占采购总额的50%以上，占比较高，其中继电器及部分 FPGA 芯片对境外采购存在一定依赖。境外采购的原材料的生产企业主要位于美国、日本及英国，若未来我国与上述国家出现重大贸易摩擦、设置关税壁垒，则可能对公司原材料供应的稳定性、及时性产生不利影响，进而影响公司的生产经营和业务发展。

应对措施：公司采购的芯片等由境外供应商生产的原材料未被相关国家列入限制出口的商品清单，不会影响原材料的稳定供应；近年来，公司以往通过境外采购的部分原材料开始转为向国内生产厂商进行采购，在供货的及时性和稳定性方面有所提升。

5.原材料价格上涨风险

若未来市场行情发生重大变化、贸易摩擦导致加征关税，则可能导致原材料采购价格上涨，将对公司的盈利能力造成不利影响。

应对措施：（1）公司实时跟踪主要原材料的市场行情，采取错峰采购政策，在价格低位的时候适当进行备货；（2） 公司积极开发新的合格供应商，采购时通过对多个供应商报价进行比价，增强公司原材料采购的议价能力，降低原材料价格上涨带来的不利影响。

6.技术人才流失的风险

技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。随着行业竞争日趋激烈，各企业对于技术人才的争夺也将不断加剧，公司将面临技术人才流失的风险。

应对措施：公司将继续坚持创新驱动发展的战略，加强对研发人才的引进和培养，持续完善研发创新激励机制，提高研发人员的稳定性。

分红数据

每股现金股利(元)	每股转增股份	每股送红股	公告日期	除权日	股权登记日	现金到账日	股份到账日
0.180	—	—	2024/05/24	2024/05/31	2024/05/30	2024/05/31	—
3.250	0.500	—	2023/04/13	2023/04/20	2023/04/19	2023/04/20	2023/04/20

每股数据（会计年度：12/31）

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
每股收益（元）	0.3500	3.3500	3.6700	1.7500	0.9500	2.3100	3.4900	/	/	/
最高成交价（元）	181.87	140.00	—	—	—	—	—	/	/	/
最低成交价（元）	54.34	89.90	—	—	—	—	—	/	/	/

财务报表

利润表（单位：百万元 会计年度：12/31）

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
营业收入	237	350	344	202	148	156	150	/	/	/
营业成本	90	121	113	68	47	47	44	/	/	/
营业利润	14	137	141	64	33	48	50	/	/	/
利润总额	14	138	141	67	33	48	50	/	/	/
所得税	—11	11	14	6	1	4	6	/	/	/
净利润	25	126	128	61	32	44	44	/	/	/

资产负债表（单位：百万元 会计年度：12/31）

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
资产										
货币资金	1,168	1,362	206	163	140	86	74	/	/	/
流动资产	1,479	1,630	503	350	273	204	208	/	/	/
非流动资产	112	75	63	35	35	35	38	/	/	/
总资产	1,591	1,705	567	385	308	239	247	/	/	/
负债										
流动负债	127	115	118	65	50	119	105	/	/	/

长期借款	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/
非流动负债	2	3	1	1	1	0	1	/	/	/
总负债	129	117	119	66	50	120	106	/	/	/
股东权益										
股本	70	46	35	35	35	31	13	/	/	/
未分配利润	178	307	186	66	11	47	122	/	/	/
所有者权益	1,462	1,588	447	319	258	119	141	/	/	/

现金流量表（单位：百万元 会计年度：12/31）

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
经营活动产生的现金流量净额	18	144	83	26	14	16	75	/	/	/
投资活动产生的现金流量净额	-60	-1	-38	-2	-3	-1	-5	/	/	/
筹资活动产生的现金流量净额	-155	1,011	-3	-1	43	-4	-25	/	/	/